

# Anteprima IDF 2008 Shanghai: Netbook, Nehalem, SSD ed USB 3.0

- Ultima modifica: Martedì, 01 Aprile 2008 13:45

Pubblicato: Martedì, 01 Aprile 2008 12:46

Scritto da Federico Diana



Intel Developer Forum si terrà a Shanghai, dal 2 al 3 Aprile: tanti saranno gli argomenti trattati, tra i quali i progetti low cost di Intel, le prossime piattaforme desktop e mobile Nehalem, la nuova interfaccia USB versione 3.0, e naturalmente i drive allo stato solido (SSD).

La [due giorni di Intel](#) dedicata agli sviluppatori si apre domani con il keynote di Xu Yang, vice presidente Intel, e proseguirà con i consueti cicli di presentazioni dei vertici della multinazionale di Santa Clara. Ecco una rapida carrellata delle novità in programma:



## Processori Atom per sistemi desktop:

Descrizione della strategia di Intel per il segmento dei personal computers fissi low-cost: i nuovi processori Atom costituiranno la base delle piattaforme a basso consumo per il basic computing.

## Piattaforme mobile con processore Atom: nuovi mercati in crescita

Una panoramica sulle opportunità di crescita per dispositivi basati sull'utilizzo di internet: i Netbook. Introduzione alla piattaforma Basic Mobile Platform 2008 con l'architettura dei processori Atom. Verrà spiegato al pubblico il BOM (Bill of Materials) relativo alla componentistica dei Netbook e le loro applicazioni. Vi sarà inoltre un chiarimento a proposito della differenza tra dispositivi mobile: Netbook, MID, UMPC e Notebook Entry Level.

## Il nuovo Classmate Intel Based: innovazione per il futuro

Introduzione alla tecnologia che coinvolgerà un gran numero di utenti e spiegazione sulla progettazione di sistemi low-cost. Sono incluse l'implementazione di caratteristiche tecniche

# Anteprima IDF 2008 Shanghai: Netbook, Nehalem, SSD ed USB 3.0

- Ultima modifica: Martedì, 01 Aprile 2008 13:45

Pubblicato: Martedì, 01 Aprile 2008 12:46

Scritto da Federico Diana

specifiche della seconda e terza generazione di Intel Classmate PC, come il drive PATA Flash Multi Level Cell, design di componenti rugged e resistenti alle alte temperature, design di sistemi fanless.

## **Dissipazione passiva e profilo termico fanless per Nettop:**

Introduzione al Nettop, roadmap dei dispositivi orientati ad internet e relative soluzioni di dissipazione. Proposte qualitative per sistemi di dissipazione passiva/fanless, e panoramica sui prezzi, rumore e utilizzo.

## **Piattaforme desktop high end, l'architettura di nuova generazione, Nehalem:**

Descrizione delle piattaforme fisse di nuova generazione, basate su Intel Microarchitecture Processor delle CPU Nehalem. Linee guida del profilo elettrico, design di sistema per progettare una piattaforma per i nuovi processori Bloomfield. Informazione sulla nuova tecnologia Quick Path Interconnect (QPI) e controller del bus integrato nei nuovi processori per desktop. Aggiornamenti a 360 gradi sulle nuove tecnologie per i sistemi desktop high end e descrizione dei vantaggi nel loro sviluppo.

## **Microsoft Windows Rally Technologies:**

Le nuove tecnologie Microsoft Windows Rally forniranno ai produttori di dispositivi dotati di connettività integrata, un'architettura che garantisce un setup facile, sicuro e capace di gestire la connettività di altri sistemi mobile o desktop, per una esperienza ricca e immediata. Usare le tecnologie Windows Rally permette agli sviluppatori hardware e software di concentrare gli sforzi sulla differenziazione dei prodotti, anziché sui fondamenti della connettività. Per gli stessi utenti vi sarà un più semplice utilizzo delle proprie risorse, ad iniziare dalla connessione ad internet di un dispositivo.

## **Drive allo stato solido SATA: non tutti i drive sono uguali**

Una descrizione tecnica dei drive allo stato solido (SSD) con interfaccia SATA basati sulla tecnologia della memoria NAND Flash ad alta performance. Analisi comparativa tra i nuovi SSD SATA Intel in arrivo, e gli altri SSD e hard disk convenzionali, con approfondimento sulle performance, consumo e affidabilità.

## **DDR3, le memorie perfette per i notebook:**

Comprensione dei benefici portati dalle nuove memorie DDR3; discussione sui vantaggi nell'impatto ambientale e implementazione nel settore mobile. Analisi approfondita delle performance, con benchmark mirati che verranno spiegati e commentati con il pubblico.

## **Extreme Mobile Gaming: considerazioni sul design dei notebook al top delle prestazioni**

Introduzione ai sistemi laptop per l'extreme gaming. Dettagli sull'offerta hardware e software. Aggiornamenti sulle tecnologie di dissipazione del calore disponibili, e sui metodi per il tuning della piattaforma.

# **Anteprima IDF 2008 Shanghai: Netbook, Nehalem, SSD ed USB 3.0**

- Ultima modifica: Martedì, 01 Aprile 2008 13:45

Pubblicato: Martedì, 01 Aprile 2008 12:46

Scritto da Federico Diana

## **Viaggio all'interno dell'architettura Nehalem di nuova generazione**

La microarchitettura Intel Nehalem è il prossimo grande aggiornamento dell'architettura Intel, previsto dalla strategia "Tick-Tock" dei processori. Durante questa sessione ne verrà approfondita la struttura inoltrandosi nei meandri della microarchitettura stessa. Verrà effettuata una panoramica riguardante i concetti chiave di Nehalem: miglioramenti nella gestione dell'esecuzione fuori ordine per il codice per le istruzioni macchina, sulla bandwidth della piattaforma, sottosistema cache, estensione delle istruzioni SSE4.2 e molto ancora..

## **Componenti della tecnologia Intel QuickAssist**

Comprensione dello scopo della tecnologia Intel QuickAssist Acceleration e delle sue componenti. Architettura hardware e software degli acceleratori Intel QuickAssist Technology FSB-FPGA e AAL. Spiegazione dell'acceleratore integrato e del nuovo System On Chip Product (nome in codice Tolapai), e del suo framework.

## **Moblin-org: sviluppo open source per i dispositivi MID Intel**

Il progetto open source Moblin.org è il cuore del software e tecnologie per i dispositivi Intel MID (Mobile Internet Device). Verranno approfonditi i dettagli tecnici per il setup dell'ambiente per piattaforme specifiche e sulla costruzione di applicazioni basate su sotto-progetti e tecnologie di Moblin.org.

## **USB Super Veloce: USB 3.0**

Panoramica del mercato "SuperSpeed" e dei tempi di aggiornamento industriale. Approfondimento sul SuperSpeed USB (specifiche 3.0) con specifiche tecniche architetturali. Guida alle opportunità dell'industria per il biennio 2008/2009.

## **Architettura Intel SoC (System-on-Chip)**

Benefici dell'architettura Intel based SoC per l'industria. Questa tecnologia di basa su una generica architettura SoC on-die; verranno esplorate le opportunità dei chip nel mercato come piattaforma per la comunicazione integrata relativa a dispositivi mobile e elettronica di consumo. Verranno esposte inoltre le aspettative di Intel a proposito dell'ecosistema industriale sul linguaggio ELC (Electronic System Level), strumenti e nuove metodologie.